

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-006

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

投资标的名称：成都东凯芯半导体材料有限公司

（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“合资公司”）

投资金额：合资公司的注册资本为人民币 7,300 万元，其中：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）认缴出资 5,500 万元，持有合资公司 75.34%的股权；韩国 Chemax Co.,Ltd（以下简称“韩国 Chemax”）认缴出资 1,000 万元，持有合资公司 13.70%的股权；上海种亿化学技术有限公司（以下简称“种亿化学”）认缴出资 800 万元，持有合资公司 10.96%的股权。

特别风险提示：本次对外投资是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理等不可控因素的影响，特别提醒投资者注意以下风险：

1.本次对外投资事项涉及跨境投资，尚需取得双方所在国家相关监管部门的审查以及注册地市场监督管理局等主管部门的备案或审批，能否通过相关审批以及最终审批的时间存在一定的不确定性。

2.随着国内光刻胶材料厂商的扩产计划实施、技术发展升级，合资公司作为新进入者，若行业产能扩充迅速或半导体行业的下游需求增长不及预期，可能会出现市场竞争激烈、阶段性产能过剩、认证进度滞缓，进而导致合资企业的经营业绩不达预期的风险。

3.截止目前，公司仅配备部分的人员储备、技术储备及相关的实验中试装置，尚未量产光刻胶相关材料。光刻胶材料行业属于技术密集型领域，技术门槛较高，

投资各方需共同攻克关键核心技术，完成新产品研发和制造，合资公司的技术工艺、产品质量是否能达到光刻胶材料的技术标准及达标时间存在不确定性。

4.在未来经营过程中，合资公司可能面临宏观经济及行业政策变化、下游市场需求、企业经营管理等不确定因素的影响，存在未来经营业绩不确定的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近年来，随着电子信息产业更新迭代的进程加快，叠加半导体、显示面板产业链东移，国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升。但中国光刻胶材料行业的产能投放大多集中在中低端领域，目前仅能实现 PCB 用光刻胶材料领域的自主供应，中高端领域（包括但不限于：显示面板用光刻胶材料、芯片制程用光刻胶材料）的技术壁垒较高，且全球供应链高度集中，基本被日韩企业所垄断。

近年来，公司一直在积极寻求新能源、新型显示、半导体等领域的项目培育和产业化投资机会。经过投资各方深入的沟通交流和考察调研，公司拟与韩国 Chemax、种亿化学共同签署《投资协议》，对外投资设立成都东凯芯半导体材料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准），重点开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务。

上述合资公司的注册资本为人民币 7,300 万元，其中：公司认缴出资 5,500 万元，持有合资公司 75.34%的股权；韩国 Chemax 认缴出资 1,000 万元，持有合资公司 13.70%的股权；种亿化学认缴出资 800 万元，持有合资公司 10.96%的股权。

（二）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方的基本情况

(一) Chemax Co.,Ltd

1、注册资本：3 亿韩元

2、法定代表人：KIM SUNG JU

3、公司住所：28-5, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

4、成立时间：2002 年 10 月 18 日

5、经营范围：从事半导体、电磁场、显示器等工业领域中所需材料的生产及销售业、咨询业等

6. 经营情况：韩国 Chemax 是韩国半导体产业链的合格供应商，成立于 2002 年，是一家拥有深厚的技术沉淀和丰富的生产控制经验的光刻胶材料研发生产企业。经过 20 年的发展历程，韩国 Chemax 研发生产的 KrF 以及 ArF 单体种类及数量几乎涵盖目前先进光刻胶材料市场上的大部分品种，是韩国光刻胶材料全面国产化的重要企业。自 2011 年起，韩国 Chemax 积极参与韩国光刻胶材料研发任务，不断丰富产品种类，并从单体着手向光刻胶专用树脂、光酸等领域进行产业链延伸，积极布局中日韩光刻胶材料的供应链体系。

(二) 上海种亿化学技术有限公司

1、注册资本：500 万元人民币

2、法定代表人：徐新宇

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢 2 层 212-23 室

4、成立日期：2016 年 4 月 7 日

5、经营范围：从事化工科技、新材料科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及其原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件、食用农产品的销

售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 经营情况: 种亿化学是韩国 Chemax 在中国境内指定的唯一合伙人, 负责韩国 Chemax 在中国的一切事务, 包括但不限于合资、合作、采购、销售等。目前, 种亿化学已与国内多家光刻胶材料制造企业建立了稳定的业务合作关系。

三、拟设立合资公司基本情况

(一) 合资公司的基本情况

- 1、合资公司名称: 成都东凯芯半导体材料有限公司
- 2、注册资本: 7,300 万元人民币
- 3、注册地址: 成都市高新区(具体以市场监督管理局的核准内容为准)
- 4、法定代表人: 周友
- 5、经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 高新技术成果的培育和产业化; 半导体制程专用光刻胶材料及相关高纯化学品研发、制造及销售; 电子材料研发、制造及销售; 化工产品生产和销售(以上均不含危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品及监控化学品, 不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(二) 股权结构及出资情况

股东名称	认缴金额 (人民币 万元)	出资形式	出资时间	持股比例
东材科技	5,500	现金、生产场地、或设备等资产	2023 年 6 月 30 日前	75.34%
韩国 Chemax	1,000	现金	2023 年 6 月 30 日前	13.70%
种亿化学	800	现金	2023 年 6 月 30 日前	10.96%
合计	7,300	/	/	100.00%

上述投资设立合资公司的基本情况具体以市场监督管理局最终核准为准。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次公司与韩国 Chemax、种亿化学共同投资设立合资公司, 拟重点开展高

端光刻胶材料的合成与纯化业务，积极布局先进光刻胶材料领域。该项目顺利实施后，有望解决我国光电行业关键性原材料“卡脖子”难题，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。

上述合资公司将充分利用投资各方的资源优势、技术积累和管理经验，快速构筑高端光刻胶材料领域的上下游协同产业链，在合作共赢的基础上，进一步提升公司的技术研发能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司经营状况及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理等不可控因素的影响，公司特别提醒投资者注意以下风险：

1.本次对外投资事项涉及跨境投资，尚需取得双方所在国家相关监管部门的审查以及注册地市场监督管理局等主管部门的备案或审批，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间存在一定的不确定性。

2.随着国内光刻胶材料厂商的扩产计划实施、技术发展升级，合资公司作为新进入者，若行业产能扩充迅速或半导体行业的下游需求增长不及预期，可能会出现市场竞争激烈、阶段性产能过剩、认证进度滞缓，进而导致合资企业的经营业绩不达预期的风险。

3.截止目前，公司仅配备部分的人员储备、技术储备及相关的实验及制造装置，但尚未量产光刻胶材料。光刻胶材料行业属于技术密集型领域，技术门槛较高，投资各方需共同攻克关键核心技术，完成新产品研发和制造，合资公司的技术工艺、产品质量是否能达到光刻胶材料的技术标准及达标时间存在不确定性。

4.在未来经营过程中，合资公司可能面临宏观经济及行业政策变化、下游市场需求、企业经营管理等不确定因素的影响，存在未来经营业绩不确定的风险。

对此，公司将积极推进合资公司的设立审批进度，密切关注合资公司的日常经营管理，不断提升技术研发水平，加强风险管控机制，积极防范和应对合资公

司发展过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年2月27日